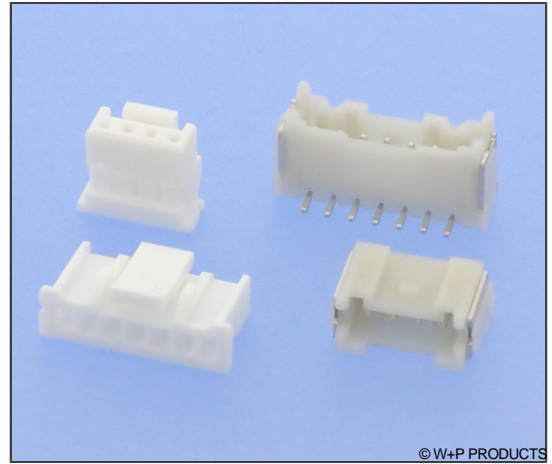


SMT-Crimp-Rast-Stiftleisten RM 2,00mm, stehend/liegend SMT Friction Lock Pin Headers, 2.00mm Pitch, Vertical/Horizontal

Technische Daten / Technical Data

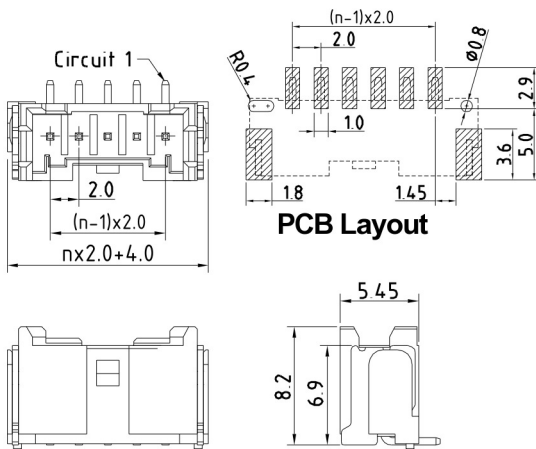
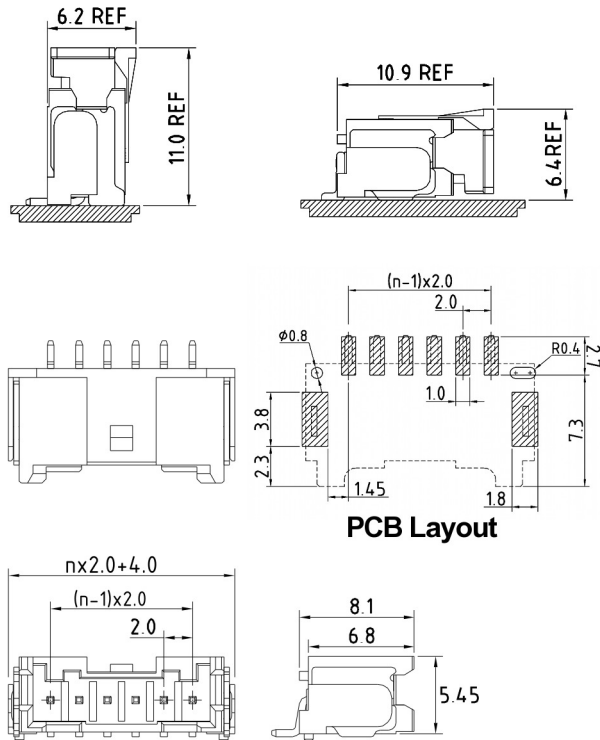
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0, halogenfrei <i>Thermoplastic, UL94 V-0, halogen-free</i>
Farbe <i>Colour</i>	Weiß / natur <i>White / natural</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung <i>Square pin 0.50mm, copper alloy</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ < 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ > 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	800 V AC 800 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC/DC 250 V AC/DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A 3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25 °C ... +105 °C -25 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passendes Buchsengehäuse Serie:
Mating housings Series:

549



Series	Contacts*	Type*	Locating Pegs*	Plating	Packaging*
5490	05	3	10	50	PPTR
	02-11 Weitere Polzahlen auf Anfrage More contacts on request	3 Stiftleiste stehend Pin header vertical 4 Stiftleiste liegend Pin header horizontal	00 Ohne Positionierhilfen W/o locating pegs 10 Mit Positionierhilfen With locating pegs	50 Sn	TR PPTR

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

TR Tape & Reel ohne Pick&Place-Pads / Tape & Reel w/o Pick&Place-Pads
PPTR Tape & Reel mit Pick&Place-Pads / Tape & Reel with Pick&Place-Pads

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

